(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年2 月3 日 (03.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/010077 A1

(51) 国際特許分類?:

C08G 77/14, 77/20, G03F 7/075

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010853

(22) 国際出願日:

2004年7月29日(29.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-203411 2003 年7 月29 日(29.07.2003) JP 特願2003-203412 2003 年7 月29 日(29.07.2003) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東亞合成 株式会社 (TOAGOSEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1058419 東京都港区西新橋 1 丁目 1 4番 1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田内 久仁和 (TAUCHI, Kunikazu) [JP/JP]; 〒4550027 愛知県名古屋市港区船見町 1 番地の 1 東亚合成株式会社 新製品開発研究所内 Aichi (JP). 鈴木 浩 (SUZUKI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4550027 愛知県名古屋市港区船見町 1 番地の 1 東亚合成株式会社 新製品開発研究所内 Aichi (JP).

- (74) 代理人: 小島 清路 (KOJIMA, Seiji); 〒4560031 愛知 県名古屋市熱田区神宮三丁目 7 番 2 6 号 熱田大同 生命ビル 2 階 Aichi (JP).
- (81) 指定国 / 表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SILICON-CONTAINING POLYMER, PROCESS FOR RPODUCING THE SAME, HEAT-RESISTANT RESIN COMPOSITION, AND HEAT-RESISTANT FILM

(54) 発明の名称: 珪索含有高分子化合物及びその製造方法並びに耐熱性樹脂組成物及び耐熱性皮膜

$$\left(A^{1}-(R^{1})_{m}-SiO_{3/2}\right)_{S} \left[R^{2}-SiO_{1/2}\right]_{L} \left[SiO_{4/2}\right]_{U}$$
 (I)

(57) Abstract: An alkali-soluble silicon-containing polymer which is represented by the following formula and has a weight-average molecular weight of 500 to 500,000. (I) In the formula, A^1 is phenyl having hydroxy or alkoxy; R^1 is C_{14} alkylene; m is 0 or 1; R^2 is C_{14} alkyl; and s and u each is a positive number and t is 0 or a positive number, provided that $0 \le t/(s+u) \le 1$ and $0 < u/s \le 5$.

[铙葉有]